



# 반도체용 드라이 에칭제 HFC-23(CHF<sub>3</sub>)

드라이 에칭제 HFC-23(CHF<sub>3</sub>)은 반도체 제조 대상 고순도 에칭 가스입니다.  
고압 가스에 해당합니다.

## 1. 일반 물성

항목	단위	수치
분자식	-	CHF <sub>3</sub>
분자량	-	70.01
비점	℃	-82
증기압(25℃)	MPa	4.729

### 【검사항목】

순분(에어분 제외), 다른 종류 프론, 산분, 수분, 에어분

\* 각각의 품질에 관해서는 문의해 주십시오.

## 2. 용도

에칭

## 3. 취급방법/안전정보

사용 전에 반드시 SDS 를 읽어주십시오.

보관, 수송에 관해서는 해당 법규에 따라주십시오.

## 4. 포장 사양

10L 용기, 47L 용기

본 제품은 공업 용도로 개발된 것으로 그 이외의 사용에 대해서는 안정성을 보증하지 않습니다.

의료 용도, 식품 용도 등으로 사용하실 경우에는 사전에 당사에 연락해 주십시오.

【연락처】 다이킨코리아주식회사

우편번호: 135-907 서울특별시 강남구 논현로 105 길 48, 나실빌딩 3층